

АДГЕЗИВЫ

BOND-1® System - однокомпонентная бонд система

Общие сведения

Бонд система BOND-1 System состоит из:

- **BOND-1 Primer/Adhesive** однокомпонентный бонд
- **BOND-1 C&B Primer/Adhesive** однокомпонентный бонд
- **BOND-1 Dual-Cure Activator** активатор двойного отверждения

BOND-1 Primer/Adhesive и BOND-1 C&B Primer/Adhesive являются однокомпонентными адгезивами на основе ацетона-этанолового раствора, работают на влажной поверхности, обладают превосходными физическими и химическими характеристиками.

Важным преимуществом системы BOND-1 является наличие активатора двойного отверждения, что расширяет сферу применения системы и дает возможность применять ее без источника светового излучения или в местах, где доступ света ограничен, например - в корневых каналах.

Основные характеристики

- Глубина проникновения в зубные ткани до 100мкм.
- Толщина поверхностного слоя от 8 мкм.
- Сила сцепления с зубными тканями: эмаль -27МПа, дентин -31МПа.
- Ярко выраженное десенсибилизирующее действие.
- Отсутствие послеоперационной чувствительности.

BOND-1 Dual-Cure Activator разработан для использования в комплексе с BOND-1 Primer/Adhesive и BOND-1 C&B Primer/Adhesive и применяется с цементами двойного отверждения или композитами для создания культы и вкладок, пломбировочными композитами химического отверждения. Его нужно использовать там, где есть ограниченный доступ света фотополимеризатора например, в корневых каналах, чтобы гарантировать надежность полимеризации без источника светового излучения. Если работа проводится с помощью материала двойного отверждения PENTRON, например BUILD-It или CEMENT-It, использование BOND-1 Dual-Cure Activator не обязательно, так как эти материалы имеют в своем составе активатор химической полимеризации, который будет инициировать химическое отверждение BOND-1.

Назначение

▪ BOND-1 Primer/Adhesive и BOND-1 C&B Primer/Adhesive: для десенсибилизации, адгезии к тканям зуба, композитам, керамике, металлам, амальгаме и др. при прямых и не прямых реставрациях.

Примечание:

Для фиксации протяженных металлических конструкций рекомендуем использовать BOND-1 C&B Primer/Adhesive, так как он содержит больше количество этанола и медленнее испаряется.

▪ BOND-1 Dual-Cure Activator для катализации химического отверждения BOND-1 Primer/Adhesive и BOND-1 C&B Primer/Adhesive в случае необходимости и в местах, где ограничен доступ света.

Примечание:

При работе с материалами двойного отверждения BUILD-It или CEMENT-It однокомпонентные бонды BOND-1 Primer/Adhesive и BOND-1 C&B Primer/Adhesive будут отверждаться без источника светового излучения.

Комплектация

отдельные компоненты:

- **N01IAB** 6мл. BOND-1 Primer/Adhesive;
- **N01IAA** 4мл. BOND-1 Primer/Adhesive;
- **N01AC** 3мл. BOND-1 Dual-Cure Activator;
- **N01IB** 5мл. 37% Etch gel
- **N31IB** 6мл. BOND-1 C&B Primer/Adhesive.

набор:

- **N01I** набор BOND-1:
 - 4мл. бонд BOND-1 Primer/Adhesive;
 - 3мл. активатор BOND-1 Dual-Cure Activator;
 - 5мл. протравка 37% Etch gel;
 - аксессуары.

В 2003 году BOND-1 System была отмечена независимым изданием:



Почему BOND-1?

- Полное отсутствие послеоперационной чувствительности.
- Надежность краевого

